

Ad-hoc-Mitteilung vom 17. September 2004

AT&S baut zweites Werk in Shanghai

Angesichts der anhaltend starken Dynamik in mehreren Segmenten der Elektronikindustrie und der dadurch steigenden Nachfrage nach Leiterplatten der hohen Technologiesegmente, wird AT&S ab sofort mit dem Bau eines zweiten Werkes am AT&S Standort Shanghai beginnen und damit ihre Wachstumsstrategie fortsetzen.

Das zweite Werk wird unmittelbar neben dem ersten, im Dezember 2002 eröffneten Werk entstehen. Die Entscheidung, ob AT&S in dem neuen Werk, das im Laufe des Geschäftsjahres 2006/07 die ersten Umsätze erwirtschaften wird, Fertigungskapazitäten für HDI Microvia oder für flexible Leiterplatten aufbauen wird beziehungsweise in welcher Aufteilung, fällt spätestens im Herbst 2005.

Das Gesamtinvestment der AT&S in das neue Werk in Shanghai wird sich, unabhängig ob flexible oder HDI Microvia Leiterplatten hergestellt werden, auf 80 bis 100 Millionen Euro, aufgeteilt auf drei Jahre belaufen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2005/06 rechnet AT&S mit einer Investition für den Bau des Gebäudes von maximal 10 Millionen Euro. Der daraus abgeleitete Gesamt-CAPEX der AT&S für 2005/06 wird sich auf maximal 35 Mio EUR belaufen.

AT&S AG, Wien, Österreich, 17. September 2004

Weitere Informationen erhalten Sie von Dr. René Berger, IRO, Tel. +43-1-68300-9215, E-Mail: r.berger@ats.net.